

## 次世代有機ELパネル共同開発 リアメタル不要に

日立製作所、東芝、ソニーナなどの中小型パネル事業の統合会社、ジャパンディスプレイ(東京・港)は、九州大学や福岡県が進める次世代の有機用スマートフォン(高

EL(エレクトロ・ルミネッセンス)パネルの開発に参加する。リアメタル(希少金属)を使わずコストを抑えた材料を活用。スマートフォン(高

(福岡市)で取り組む研究に参画する。同センターにはパナソニックや富士フイルムなども参加

し、材料や素材で九大と個別に研究開発を進めている。

DF」と呼ばれる発光材料を使ったパネルを開発する。TADFはリアメタルを原料とする「リンクル機能携帯電話(スマホ)」など向けに2015年度以降の量産を目指す。

九大などが10年に設立した最先端有機光エレクトロニクス研究センター

申請している。今後はりん光材料に比べて劣つている発光効率の引き上げを図るほか、中小型パネルに対する耐久性やコストを評価する。

スマホ向けなど中小型の有機ELパネルは韓国

サムスン電子グループが世界シェアの8割を握